ジャケットの腐食と防食(その2)

Jacket Corrosion and Its Protection (Part 2)



Previous paper introduced some of our recent experiences with corrosion accidents in jacket caused by cooling water, describing how corrosion takes place and how such corrosion can be prevented. In this paper, electroless Ni plating is introduced as a protection against jacket corrosion and also methods of treating liquid for inhibiting corrosion and scale build up on Ni plated surface.

Fえがき

前報¹⁾では,主として冷却水によるジャケットの腐食に ついて,腐食はどうして起こるか,腐食はどうして防ぐか 二主眼をおき,最近当社で経験した事例を含めて解説し こ。本報では,当社の防食法の一つであるジャケット部へ)無電解 Ni めっき施工技術の紹介と,めっき面の耐腐食 と,耐スケール性,及び環境処理についても言及する。

腐食の発生やその進行速度には、さまざまな因子が作用 る。この因子を変化させ、腐食が抑制される方向に向か っせれば、すなわち防食である。防食方法として、一般に 認識されている最も身近なものは、金属の表面を被覆して 環物質を遮断する方法で、塗料を塗る、めっきをするな が代表的な例である。めっきを利用して、素材に耐食性 っ耐摩耗性を付与する方法の一つに無電解 Ni めっきがあ っこのめっきは、Ni 塩と次亜りん酸塩を主成分とする 品谷中に被覆物を浸漬し、化学的な還元作用によって行う のである。最近では、めっき液が大幅に改良され、コス 、ダウンが進み非常に簡単な技術と設備でめっき作業が行 えるようになった。

当社では、すでにその特性に着目し、1980年に高効率重 合反応装置の内部ジャケット部に、冷却水に接する部分の 防食と伝熱係数の経年低下を防ぐことを目的に施工してお り、一般のジャケット部を含め現在までに数10基に施工し てきた。(第1表)本稿ではジャケットへの無電解 Ni めっ き施工技術、めっき面の 耐腐食性 及び 耐スケール性につ いて、実験結果を中心に言及する。

- 1. ジャケットへの無電解 Ni めっき施工技術²⁾
- 1.1 めっき施工試験

第1図に無電解 Ni めっき実験フローを示した。20A短 管及びモックアップを使用し,各種実験を実施した。 本実験で得られた結果としては,

- めっき液の組成並びにめっき条件は、めっきメーカー 間で、微妙に異なるが、結果として、ほとんど差異は認 められなかった。
- (2) 管内流速による影響については、面流速が一定値以下 では、同一操作条件下で所定のめっき膜厚が得られた。

ĭ	1	表	無智	電角	释 Ni	めっ	き	紑	フ	、装	置	
_	1. 1 .	- 1	D1									

Encertoress in-plated installations							
Capacity of reacter (M ³)	Namber of units	Date of delivery					
45	1	80—8					
65	1	90—2					
45	2	90—5					
65	1	91—1					
68	2	913					
80	2	91—7					
110	2	91—8					
123	2	91—11					



Fig. 1 Experimental apparatus for electroless Ni-plating

1.2 モックアップテスト

炭素鋼製モックアップ構造断面を**第2図**に示す。この構 造の目的は,ガス溜り部,隙間部及び溶接部を設け,それ らの部位のめっき挙動を観察するためのものである。 その結果,

- (1) 上層部エアー溜り部には当然めっきは付かない。
- (2) 溶接部上及び隙間部のめっき状況は,外観及びその断面ミクロ観察からいずれも良好である。

1.3 実機への適用

プロセス及び工事手順の概要を 第2表 及び 第3図 に示 す。また実際の無電解 Ni めっき施工状況を写真1 に示す。 大型容器施工上のめっき操作のポイントは,還元反応の進 行に伴う亜りん酸 Ni 沈澱の形成や, 被めっき体以外の還 元進行を防止する錯化剤や安定剤の監視と適切なコントロ ールがめっき中に正しく実施されることである。



第2図 モックアップ断面 Fig. 2 Sectional view of mock up



Table 2 Process and work procedures

Process	Work procedures and remarks
Surface preparation (Polymerizing vessel)	Apply shot blast equivalent to SPC 5 SSPC Standard. Afterward, grind nozzle welds for finish
Preparation for plating	Install operation pedestal, pumps and tanks Perform piping, insulating, electric and scaffolding work. Perform leak test by test run with wate followed by additional tightening, i necessary. Suspension of plating liquid and adjust ment of acid liquid.
Operation and heating of boiler	Heat polymerizes vessel and plating basin up to 80~90°C.
Washing with water	Carefully wash portions to be plated with water. If grease is found during washing operation, add deoiling process to remove grease.
Acid treattment	Perform acid treatment at temperature a below 50°C at lower concentrations in a short time.
Washing with water	Continue washing with water until acid is completely removed, confirming with PH test paper that acid is not present
Plating	Perform plating for $2\sim3$ hours per batch by controlling temperatures at $80\sim95^{\circ}$ C PH at $4.5\sim4.8$ and Ni concentration a $4.5\sim4.8g/\ell$.
Washing	Continue washing wath water unti plating liquid is completely removed confirming with color that liquid is no present.
Alkali treatment	Perform washing with low-concentration alkali.
Washing with water	
Drying	Dry with air (7 K air) ·
Inspection	Visually inspect internal surface through nozzle.
Washing with water of attached apparatuses after diassembly	Wash plating apparatuses with nitrie acid.



写真1 無電解Ni めっき施工状況 Photo.1 Status of electroless Ni plating process



第3図 無電解 Ni めっき配管系統図 Fig. 3 Piping diagram of electroless Ni-plating

3表 1バッチ当りの主操作条件 ble 3 Procedure for one batch

cid treatment	Temperature : RT~50 °C Concentration : HCl 5 %			
ating	Temperature : 70~90 °C pH : 4.5~8.4 Ni concentration : 4.5~4.8 g/l			
kaline treatment	Temperature : RT~50°C NaOH concentration : 2~3 %			
ying	Temperature : RT Air pressure : $3 \sim 5 \text{ kg/cm}^2$			

Boiler heat up: within 2 hrs

第3表に1バッチ当りの主操作条件との一例を示す。施 支術上の留意点及び納期の遵守,安全対策については次 示す配慮をしている。

被めっき素地が,めっき中に大気に触れると,めっき がそれ以上かからないことが多く,ポンプの故障や,配 管のホース外れ等による一時中断は許されない。従っ て,

ポンプは必ず,予備を設け,トラブル時はバルブで切替 え出来る配管としている。

記管はワンタッチクイックカプラーで接続し,予備配管 並びに配管継類,バルブ等も予備を常備しておく。

と試運転時,昇温,冷却繰返しテストを必ず実施し温度 差による洩れ対策をあらかじめ講じておく。

4 無電解 Ni めっきの判断基準

欠の項目を検査基準とし、総合判定する。

) テストピース浸漬

看環液出口からめっきタンクへ戻るタンク液中にテスト ピースを吊り下げ,めっき前後のめっき膜厚を 1/1000 nm マイクロメーターか 化学天秤で測定する。断面ミ クロ観察の一例を写真2に示した。

) 定量分析テスト

めっき開始,終了間の № 消耗量を計算し,めっき皮膜 享みを算出する。表積面×比重×厚み=重量

厚み(μm)=重量(g)×10 000/表面積(cm²)×比重(g/ xm³)

) 外観所見

各ノズル部よりライト等により,めっき表面状況を観察 し,光沢,色調,ザラツキ,異物の有無等を調査する。



Photo. 2 Microstructure of sections

2. 無電解 Ni めっきの耐腐食性³⁾

無電解 Ni めっきは耐食性が良好なことから,防食法の 一つとして適用されているが,水環境下で使用されるよう な場合,Ni めっきは鋼に比べ貴な電位を示すため,Ni め っき皮膜にピンホールや亀裂等の欠陥が存在すると下地鋼 板の腐食を著しく促進することが懸念されるが,その腐食 速度の 定量的な把握や 防食方法 については 不明な点が多 い。本実験では Ni めっき鋼板のめっき被膜欠陥部におけ る電食挙動を想定し,水溶液の電導度や,鋼/Ni めっき皮 膜の面積比の影響について 調べるとともに,Ni めっきた ピンホール等の欠陥部が存在した場合の電食防止方法とし てインヒビターの添加効果についても検討を加えた。

2.1 実験方法

2.1.1 供試材及び試験液

供試材として無電解Niめっき鋼板(Ni-8 wt% P-30 μ m) 及び炭素鋼板(C: 0.10, Si: 0.22, Mn: 1.01, P: 0.014, S: 0.003%)を用い,必要に応じてマスキングを施した。 また,試験液としてはイオン交換水に NaCl を加えて,イ オン交換水(1.44×10⁻⁶s/cm),工業用水レベル(1.57× 10⁻⁴s/cm),及び海水レベル(4.53×10⁻²s/cm)の3種 類の電導度の異なる水溶液を調整して用いた。腐食抑制剤 としては市販のインヒビターを100~1000 ppmの範囲で 添加した。

2.1.2 電食電流測定

無抵抗電流計により、炭素鋼と Ni めっき皮膜間の電食 電流の経時変化を測定し、浸漬してから24時間経過後の安 定した電流値を用いて腐食速度を算出した。試験液の温度 は60°Cとし、炭素鋼/Ni めっき面積比を 1/1~1/9 000 の 範囲で変化させた。

2.1.3 浸渍腐食試験

無電解 Ni めっき鋼板の中央部にあらかじめ約 1.0 mm のめっき欠陥部を設けた試料を作成し, 3.1.2項の測定と

同様,電導度の異なる3種類の水溶液中に10~30日間浸漬 した後,断面の光学顕微鏡観察により腐食状況を観察し た。

2.1.4 自然電位の経時変化

工業用水レベルの水溶液(60°C, 大気開放)を用いて 自然電位の経時変化を測定した。またインヒビターの添加 の影響についても調査した。

2.1.5 分極曲線測定

自然電位の測定と同様の工業用水レベルの水溶液(60°C 大気開放)を用いて動電位法により,陰分極及び陽分極曲 線の測定を行った。またインヒビター添加の影響について も調査した。

2.2 実験結果及び考察

2. 2. 1 炭素鋼 vs Ni めっき皮膜の電食挙動

1)浸漬腐食試験

写真3に各種電導度の試験液に 60°C で30日間浸漬試験 後のピンホール部断面観察結果を示す。ピンホール欠陥部 の断面腐食状況はイオン交換水レベル (1.44×10⁻⁶S/cm) では約0.1 mm の腐食深さが認められるが,工業用水レベ ル (1.57×10⁻⁴S/m) 及び海水レベル (4.53×10⁻²S/cm) では 30 日浸漬において完全に鋼板肉厚 (0.4 mm) を貫通 しており Ni めっき皮膜を残して素地鋼板の腐食が進行し ていることが分かる。すなわち,試験液の電導度が大きい ほど Ni めっき欠陥部の腐食の著しいことが確認された。 特に Ni めっき皮膜の直下の腐食が著しいことが明瞭で, これは典型的な異種金属接触腐食(電食)によるものと考 えられる。

2)電食電流(I)

各種電導度の試験液を用いて炭素鋼と Ni めっき接触に よる電食電流の 測定結果から 炭素鋼の電食(Fe→Fe²⁺+ 2e⁻)の腐食速度を 算出し, その結果を 第4,5図に示 す。第4図より水溶液の電導度が大きいほど炭素鋼の腐食 速度は 増加する傾向が明確である。また第5図より炭素鋼 /Ni めっきの面積比が小さいほど炭素鋼の腐食速度は著し く増大する。炭素鋼/Ni めっきの面積比及び炭素鋼の腐食 速度を共に対数目盛で表示すると,両者はほぼ直線的に変 化することが分かる。

炭素鋼単独浸漬の腐食速度は約0.3 mm/y であり試験液 の電導度の影響は明確ではないが、炭素鋼/Ni めっきの面 積比が1/9000の場合,海水レベル(4.53×10⁻²S/cm)の 試験液では約1400 mm/y である。また化学工業の冷却水 として最もよく使用される工業用水レベル(1.57×10⁻⁴S/ cm)においても約800 mm/y と非常に大きな腐食速度を 示すことが分かった。Ni めっき皮膜に ピンホール等の欠 陥部が存在した場合には、炭素鋼露出部の面積は Ni めっ き皮膜の面積に比べて極微小であると考えられるので炭素 鋼露出部の腐食は炭素鋼単独の場合に比べて著しく促進さ れる。

2. 2. 2 電食防止方法の検討

例えば、ジャケットの内面に無電解 Ni めっきを適用す る場合にはピンホールを皆無にすることは非常に困難であ る。このため鋼の表面に緻密な酸化皮膜を形成し鋼の腐食 を抑制する効果が期待されているインヒビターの添加によ る防食効果を検討した。



写真3 Ni めっきピンホール部の腐食状況

- (浸漬60°C 30日間)

Photo. 3 Corrosion ocurred at pinhole portion of Ni plating (Dipped in 60 °C liquid for 30 days)









)浸漬防食試験

工業用水レベル (1.57×10⁻⁴S/cm)の試験液(60°C) 市販のインヒビターを 1000 ppm 添加した場合, Ni め き単独浸漬による腐食速度は 0.002 mm/y 以下で非常に さいことを確認した。

) 電食電流(Ⅰ)

2.2.1項1)と同様の方法により工業用水レベルの水溶 にインヒビターを 100,500,1000 ppm 添加して電食電 測定を行った。インヒビターの 添加により炭素鋼と Ni っき皮膜の間の電食電流はインヒビターを添加しない場 とは 逆向きとなり,Ni めっき皮膜が 溶解する方向に変 にた。第6 図に電食電流測定結果から算出した Ni めっ 皮膜の腐食速度を示す。これらの結果より,炭素鋼/Ni っきの面積比が大きくなるほど Ni めっき皮膜の腐食速 は増加する傾向にあるが,実用上炭素鋼の露出面積は極 小であるので,インヒビター100 ppm 以上の添加の場合 i めっき皮膜の腐食速度は 10-4mm/y 以下であると考え れる。

自然電位の経時変化

第7図に工業用水レベル $(1.57 \times 10^{-4}$ S/cm)の水溶液に ンヒビターを添加した場合の炭素鋼及び Ni めっきの24 間経過後の自然電位とインヒビター添加量との関係を示 。インヒビターの添加量の増加に伴い炭素鋼の自然電位 卑方向へ移行する傾向があり、約100 ppm 以上の添加で 素鋼と Ni めっきの電位は逆転しはじめ 1 000 ppm では 素鋼の自然電位は約-260 mV vs. SCE で Ni めっきの自 :電位は約-450 mV vs. SCE となった。

)分極曲線測定

第8図に工業用水レベル (1.57×10^{-4} S/cm)の水溶液に ンヒビターを1000 ppm 添加した試験液(60°C)中に ける分極曲線測定結果を示す。炭素鋼では1000 ppm の ンヒビターの添加によって自然電位が貴に移行し,また 分極曲線には不動態域が認められるようになるが,陰分 曲線にはほとんど影響を及ぼさないことが分かる。一方, i めっき皮膜では1000 ppm のインヒビターの添加によ て自然電位,陽分極曲線,陰分極曲線にはほとんど影響 認められなかった。これらのことからインヒビターの添 によって炭素鋼の電食が防止されたのは,炭素鋼がイン ビターの作用で不動態化するためと考えられる。すなわ ,工業用水レベルの水溶液にインヒビターを添加するこ によって Ni めっき皮膜は,炭素鋼に対してむしろ防食 用をすることが分かった。

3 まとめ

無電解 Ni めっきをジャケットに適用するために Ni め き皮膜のピンホール, 亀裂等欠陥部の電食挙動を調べる 共に, その防食方法としてインヒビター添加の効果につ 、て検討した。その結果, 次のことが分かった。

)工業用水中において炭素鋼/Ni めっき面積比が小さいほ ど炭素鋼の電食速度は著しく増大する。

)水溶液の電導度が大きいほど炭素鋼の電食速度は増大す る。

)工業用水中にインヒビターを100 ppm 以上添加すること によって炭素鋼と Ni めっき皮膜の自然電位は逆転し Ni めっき皮膜は炭素鋼に対してむしろ防食作用をする。



第6図 炭素鋼とNiの電食に及ぼす面積比の影響





第7図 Ni 及び炭素鋼の自然電位とインヒビター濃度の関係 Fig. 7 Relation between corrosion potential and inhibitor concentration of Ni and carbon steel





④工業用水中にインヒビターを100 ppm 以上添加した場合のNi めっき皮膜の速度は10⁻⁴mm/y 以下であると考えられる。

3. 無電解 Ni めっきの耐スケール性4)

3.1 スケールとは

スケールは,水中の塩類が溶解度を超えたとき,その塩 類が結晶化したものや,水中の懸濁物質(SS分)が凝結, 成長し,硬質付着物となるものである。冷却水系では,主 として炭酸カルシウム,硫酸カルシウム,珪酸系の塩,腐 食生成物等がスケール成分となるが,その他腐食防止の目 的で添加される腐食防止剤の主成分も単独あるいは水中の 塩類との結合によりスケールとなる場合がある。

次に水中で起るスケール成長反応の主なものを示す。

$$Ca(HCO_3)_2 \rightarrow CaCO_3 \downarrow +H_2O+CO_2 \uparrow$$

(曝気又は加熱による分解)
 $Ca(HCO_3)_2+2OH^- \rightarrow CaCO_3 \downarrow +CO_3^{2^-}+2H_2O$
(アルカリとの反応)
 $CaCl_2+SO_4^{2^-} \rightarrow CaSO_4 \downarrow +2Cl^-$
(硫酸イオンとの反応)
 $2Fe(OH)_2+H_2O+1/2O_2 \rightarrow 2Fe(OH)_3$
(鉄の腐食による水酸化物の生成)

これらのスケールの付着速度は、水質、水温、流速、伝 熱量等の環境因子により大きく変化するが、このうち炭酸 カルシウムスケールについては、水質、水温の因子のみに より、そのスケール性の指標とすることがある。これをラ ンゲリア指数又は炭酸カルシウム飽和指数という。(第9 図)。

ランゲリア指数が正の値であればスケール発生傾向,逆 に負の値であれば腐食傾向とみなす。しかしこの数値はあ くまで目安であり,スケール傾向であるからといって,腐 食障害が全く起こらないという意味ではないので注意が必 要である。またランゲリア指数やリズトー指数による傾向 は,ある水温,水質における性質のみを表したものである ため伝熱面等での部分的な水温の上昇や腐食の発生部に起 こる pH の上昇等の原因によるその傾向を無視したスケー ルの発生は予想できない。

3.2 スケールの発生機構

水中で難溶性の塩分が溶解度以下にあるとき,それらは イオンとして存在する。しかし溶解度を超えたとき,塩は 単一物質として存在を始める。これが結晶の核となる。こ れら単一物質は経過時間と共に成長を始める。(第10図) この様に,不飽和状態である水は,結晶核の生成が起こら ないため結晶の析出はない。しかしながら,熱交換部を有 する系では伝熱面で発生する境膜内での温度の上昇及び濃 縮,腐食発生部分でのアルカリ度の上昇等,局部的な環境 の変化により,その部分で過飽和現象が発生する。水中に 存在する粒子は,その電気的な性質が弱いため,互いに凝 結し合う性質をもっており,これがスケールになる。

3.3 試験概略

第11図の二重管試験装置を用いて実装置(ジャケット) とできるだけ近似条件に設定して,試験水(各濃度の冷却 水合成水)を一定期間循環し,スケール付着防止及び腐食 防止の性能を評価する。すなわち第11図のように外套管中 に軟鋼チューブを挿入して二重管を作り,軟鋼チューブ内 に加温液を通し,このチューブと外套の間に冷却水を通し



1. Condition	2. Calculation on the nomograph	3. Calculation	4. Judgement
Water temp. =50 °C pH=8.0 Ca hardness =120 ppm M-alkaninity =100 ppm Total solid =210 ppm	Ca hardness PCa line \rightarrow PCa=2.92 M-alkalinity PAlk line \rightarrow PAlk=2.70 Total solids Temperature line \rightarrow C=1.68	pHs=PCa+PAlk+C =7.30 ls=pH-pHS =8.0-7.30 =0.70	A tendency to form the scale in water

第9図 炭酸カルシウム飽和指数計算図 Fig. 9 Saturation index (Langerier) nomograph



第10図 結晶の成長

Fig. 10 Growth of crystals



Fig. 11 Dual tube testing device



写 真 4 二重管試験装置 Photo. 4 Dual tube testing device

て冷却水側伝熱面の腐食,スケールを評価する方法で,流 速や伝熱条件を任意に設定して運転する。軟鋼のテストチ ューブは1系列につき3本組とし乱流の影響を除くため上 下の2本を省き真中の1本で評価を行うようにした。写真 4に二重管試験装置の外観を示す。また試験条件及び水質 を第4表に示す。テストチューブでの処理及び主要測定は 次の通りである。

秤	量	試験前重量		А	(mg)
		試験後酸洗前	前重量	В	(mg)
		酸洗後重量		С	(mg)
計	算	腐食減量	D=A-	С	(mg)
		付着物量	E = B -	С	(mg)

腐食速度

 $G = \frac{E(mg) \times 30}{ \overline{r} z \wedge \overline{r}_{2} - \overline{z} \overline{z} \overline{a} \overline{d} \overline{d} (cm^{2}) \times 試験日数(day)}$

3.4 試験結果及び考察

第5表及び第12~15図に試試験結果をまとめて示す。 すなわち,

1) 薬剤無添加の Ni めっきチューブのスケール付着速度 は濃縮度3倍で1.1 mcm, 濃縮度5倍で1.3 mcm, 濃縮 度8倍で1.6 mcm と濃縮度に比例して大きくなってい るが,数値的には非常に小さい。仮にスケール付着速度 が1.6 mcm とした場合の含水スケール厚みを計算する と次の式で求められる。

<条件>スケールの組成:炭酸カルシウム(比重2.83, 含水率:60%)

第4表 試験条件及び水質

 Table 4
 Test condition and water quality

Test condition	
Cooling water (°C)	40
Hot water (°C)	77
Feed velocity (m/sec)	0.5
Heat transfer (kcal/m ² •hr)	50 000
Water capacity (l)	10
Test tube	STB (Ni-plated)

Quality of cooling water						
Concentration	3	5	8			
pH	7.8	8.6	8.6			
Electro conductivity (μ S/cm)	540	700	1 4 4 0			
M-alkalinity (mgCaCO ₃ / ℓ)	90	150	· 240			
Total hardness (mgCaCO ₃ / ℓ)	120	150	320			
Ca hardness $(mgCaCO_3/\ell)$	90	120	240			
Chroride ion (Cl^-/ℓ)	63	86	168			
Sulfate ion $(mgSO_4^{2-}/\ell)$	60	67	160			
Ionized silica (mgSiO ₂ / ℓ)	24	70	64			

第5表 試験結果の一例

Table 5 Example of test result

• Concentration factor: 5

• Detention time : 120 hr

• Test period : 5 days

No.	Inhibitor	Addition (mg/l)	Corrosion rate MDD	Adhesion rate MCM
1	Blank	—	2.4	1.3
		80	0.6	0.1
3	Inhibitor(A)	100	0.2	0.1
4		120	0	0.1
5		60	0.6	0.1
6	Inhibitor (B)	80	0.5	0.1
1		100	0.5	0.1

MDD : mm/dm²-day

MCM : mg/cm²-month

- 含水スケールの比重は水の比重を1とすると 2.83×0.4+1.0×0.6=1.73 となる。
- (2) 含水スケールの1年後の付着量は1ケ月の付着量の 3倍が1年後の付着量になるから 1.6mcm×3÷0.4=12mg/cm²となる。
- (3) よって, 1年後の含水スケール厚みは

$$\frac{12 \text{mg/cm}^2}{1.73 \text{g/cm}^3 \times 10^3} \times 10 = 0.07$$

よって、一般に熱交換器の汚れ係数の許容値を0.001m²·hr·°C/kcal とした場合、CaCO₃ スケールでは、 その厚みが約0.5 mm で許容されることから、スケー ル付着速度1.6 mcm の場合の含水スケール厚み0.07mm はスケール障害とはならない数値である。

- 2)供試薬剤の中で最適薬剤は濃縮度により変える必要が ある。
- 3)薬剤添加のスケール付着速度は、 濃縮度3倍、 薬剤 100 mg/ℓ 添加で0.4 mcm、 濃縮度8倍、薬剤100 mg/ℓ で0 mcm と無添加に比べ非常に良好である。
- (4) 薬剤無添加の Ni めっきチューブの腐食速度は、濃縮 度3倍、5倍、8倍共に 2.4 mmd とやや大きくなって いる。
- 5) 薬剤添加の腐食速度は,薬剤 80 mg/ℓ で 0.5 mdd,濃 縮度 8 倍,薬剤 100 mg/ℓ で 0.4 mdd と無添加に比べ良 好である。



第12図 薬剤無添加の濃縮度とスケール付着速度の関係 Fig. 12 Relation of scale build up rate and concentration factor with no inhibitor



第13図 薬剤無添加の濃縮度と腐食速度の関係

Fig. 13 Relation of corrosion rate and concentration factor with no inhibitor

- 6)薬剤無添加の鉄の地肌の部分には、濃縮度5倍、8倍 ともに炭酸カルシウムスケールの付着が多量見られ、鉄 の腐食過程でカソード部($1/20_2+H_2O+2e^-\rightarrow 2OH^-$)が アルカリになるためスケールが析出しやすいことが確認 された。 スケール付着速度は濃縮度5倍で約80 mcm, 濃縮度8倍で約160 mcm と非常に大きく、濃縮度に比 例して大きくなる。
- 7) 薬剤添加のスケール付着速度は濃縮度5倍, 薬剤100 mmg/ℓ添加で2.3 mcm と無添加に比べて非常に良好で ある。

3.5 まとめ

薬剤無添加の STB-35(鉄), ステンレスチューブにはス ケールが付着しやすいが, Ni めっきチューブにはほとん どスケールが付着しないことが確認された。また Ni めっ きチューブの薬剤無添加の腐食については2.4 mdd とやや 大きいものの, 薬剤添加の腐食速度がすべて小さくなって いるところから, 薬剤添加による防食効果が確認された。



第14図 濃縮度5倍の場合の薬剤とスケール防止効果の関係 Fig. 14 Scale inhibiting effect of inhibitor at five times concentration



第15図 濃縮度 5 倍の場合の薬剤と防食効果の関係Fig. 15 Corrosion proof effect of inhibitor at five times concentration

さらに薬剤による Ni めっきの溶出については、卓上テス ト結果から溶出は全く問題なかった。しかし Ni めっきか 不完全で、鉄の地肌が若干ある場合は鉄の部分に炭酸カル シウムのスケールが付着すると同時に、腐食が起こり、U 値の低下、Ni めっき剝離の 誘発等の問題 となるところか ら、薬剤処理をレコメンドする。

むすび

本報では当社の防食技術の一つであるジャケット部への 無電解 Ni めっき施工技術の紹介と、めっき面の耐腐食性, 耐スケール性及び環境処理について、筆者らの実験結果と 若干の文献を引用して解説した。この解説がユーザの方々 にとって少しでもご参考になるならば幸甚に思う。

〔参考文献〕

- 1) 宮崎公志: 神鋼パンテツク技報 Vol. 37 No. 1 (1993) p.
- 2) 宮崎公志, 栗林宏明: 神鋼パンテツク技報 Vol. 35 No. :
- (1991) p. 20
- 3) 宫崎公志,栗林宏明:腐食防食'92講演大会予稿集
- 4) 中西敬昌:化学装置 Vol. 34 No. 2 (1992) p. 50